## Photo-Dissociation of Silicon Cluster

伝正 丸山 茂夫(東大工)機学 坂本 雄志(東大工学)

機学 \*木村 大(東大工院) 伝正 井上 満(東大工)

Shigeo MARUYAMA, Dai KIMURA, Yu-shi SAKAMOTO and Mitsuru INOUE Dept. of Mech. Eng., The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

The photo-fragmentation characteristics of small silicon clusters were studied with the reflectron type time-of-flight (TOF) mass spectrometer. Positive silicon clusters of 1 to 11 atoms were generated by the laser-vaporization supersonic-expansion cluster source. After the mass selection, the focused 3rd harmonics of Nd: YAG laser was irradiated to the cluster beam in the field free region before the reflectron. The reflectron voltages were adjusted so that fragments that had lower kinetic energy could be distinguished by the arrival time to the MCP ion detector. The measured fragmentation patterns from Si<sub>x</sub> (6 x 11) were compared with a simple estimation based on *ab initio* binding energy of Si<sub>x</sub><sup>+</sup> (2 x 10) clusters.

Key Words: Time of Flight, Cluster, Laser, Fragmentation, Reflectron, Silicon

1. はじめに 原子・分子クラスターとレーザー光との干渉に関して は多くの応用の可能性が示唆されているにも関わらず,その物理 機構には未知の部分が多い.理論的には,量子分子動力学法を用 いた取り扱いが進められているが,実験的に一定のサイズのクラス ターが一定の波長のレーザー光によってどの様に干渉を受けるか といった基礎的な知見が渇望されている.著者らは前報<sup>10</sup>において 原子数2~6のシリコンクラスターイオンに355nmのレーザー光を 照射し,解離の傾向を検討したが,本報においては,より大き、シリ コンクラスター(原子数611)に着目し,マスゲートによる質量選別 などの実験装置の改良の上で,同様の実験を行った.

2. 実験装置 レーザー蒸発・超音速膨張法により生成されたクラス ターは、Fig. 1 に示すように、イオン加速部において、イオン化用レ ーザーによってイオン化されると同時に予め電極間に加えられた 電場によって二段加速された後、イオン偏向板により飛行方向を補 正される. 解離実験を行う際は、マスゲートに加速電圧以上の高電 圧を加えておき、適切な時間にパリレス的に電圧を下げることによっ て特定の質量のクラスターのみを通過させた後、解離用レーザー を直交方向から照射してクラスターを解離させる.レフレクターによ リ跳ね返されるのにかかる時間はイオンの質量により異なるため、 最終的にマイクロチャンネルイオン検出器(MCP)に到着する時間 は解離する前のイオン及び解離してできた各質量のフラグメントイ オンではそれぞれ異り、既知の装置寸法、加速電圧を用いて計算



Fig. 1 Schematics of Fragmentation Experiment

することができる.マスゲート,解離用レーザーを用いない場合は 通常の質量分析となる.

3. 実験結果 Fig. 2 にシリコンクラスターの質量スペクトルの例を示す. 横軸はシリコンの原子数である.また, このスペクトルは 100 回のデータを平均したものである.このスペクトルにおいては原子数が11 より大きいクラスターのピークは認められない.イオン化にはArF エキシマレーザー(193nm, 15mJ/cm<sup>2</sup>)を用いており,大きいサイズのクラスターはイオン化と同時に解離してしまっていると考えられる.実際に,イオン化用レーザーのフルーエンスを0.5mJ/cm<sup>2</sup>程度まで小さくすることにより大きなクラスターの質量スペクトルが検出された.

解離実験では 0.3 秒毎に解離用レーザーの ON/OFF を繰り返し て行い, それぞれについて 200 回のデータを平均したスペクトルを 得た. Fig. 3 に例として Sig<sup>+</sup>の解離実験で得られたスペクトルを示す.





Fig. 3 Spectra of Fragment Ions from  $Si_8^+$ (a) With Zap Laser ; (b) Without Zap Laser ; (c) (a - b) × 3

横軸はイオン化用レーザー照射からの経過時間である.解離用レ ーザーには Nd:YAG レーザー(3 倍波, 355nm, 20mJ/cm<sup>2</sup>)を用い た.(a)が解離用レーザーを照射した場合,(b)が照射しない場合,(c) はそれらの差を取ったものであり解離用レーザー照射の効果のみ を見ることができる.また,各電圧,装置寸法より計算されたそれぞ れの大きさのフラグメントイオンの到着時刻を併せて示してあり,こ れに対応した時刻にピークが認められる.親イオンの減少量がほ ぼフラグメントイオンの総量と等しいことから,ほとんどすべてのフラ グメントイオンを検出していることが分かる.解離用レーザーを照射 しない場合のスペクトルにおいても小さいピークが認められる場合 があるが,これは,イオン化用レーザー照射により励起されたクラス ターが加速領域を通過後に解離して生じたものが,解離用レーザ ー照射により生したフラグメントと同じ時刻に MCP に到着したため と考えられる.

同様にして  $Si_6^+ ~ Si_{11}^+$ について解離実験を行った結果得られた 差のスペクトルを Fig. 4 に示す.横軸は狙動部刻をシリコンの原子 数に換算したものである.尚, $Si_2^+ ~ Si_5^+$ の解離実験においては,ほ とんどが中性のシリコン原子を一つ失ったフラグメントイオンのみが 検出された<sup>(1)</sup>. $Si_8^+$ 以下では中性のシリコン原子を一つ失ったフラグ メントイオンのピークが最も大きくなっているのに対して,より大きい シリコンクラスターについては  $Si_9^+ ~ Si_6^+, Si_{10}^+ ~ Si_6^+, Si_{11}^+ ~ Si_7^+, Si_6^+$ のピークが特徴的に大きくなっている.

4. 考察 シリコンクラスターイオンはレーザーの光子のエネルギー によって最終的に振動励起され、いくつかのイオン及び中性のクラ スターに解離すると考えられる.その際,質量の大きいクラスターの 方が一般にイオン化ポテンシャルが小さく(Fig. 6), 陽イオンになり やすいと考えられる.また,仮に中性の原子が一つずつ解離して いくと考えると、Siu<sup>+</sup> Si<sup>+</sup><sub>7</sub>, Si<sup>+</sup>に対して, Siu<sup>+</sup> Si<sup>+</sup><sub>6</sub>などの特徴が説 明できない.これらのことから , Sin<sup>+</sup>の解離過程として Sin<sup>+</sup>  $Si_{x}^{+}$  + Si<sub>n-x</sub>(x n-x)の一段反応が支配的であると考え,解離後の結合 エネルギーの和を E<sub>n</sub> = E<sub>n</sub> +E<sub>n</sub> として , 親クラスター Si<sub>n</sub> からのフラ グメント Si<sub>nx</sub> の割合を  $P_{nx} = \{\exp(E_{nx}/kT)\}/\{\sum \exp(E_{ni}/kT)\}$ のよう に仮定し, kT = 0.5 eV の場合について解離パターンを予測したも のを Fig. 5 に示す.ここで,結合エネルギーとして HF(MP4)による 理論計算の結果<sup>(2)</sup>を用い(Fig. 6), イオンと中性クラスターのエネル ギーの違いについては無視した.また,実験結果は得られたスペク トルのピークの時間積分値をフラグメント全体に対する比で示して ある.若干の差はあるものの,結合エネルギーのみを考慮したこの ようなシンプルな考え方で大まかな傾向が記述できていることが分 かる.しかし, Si, ~ Si, + については比較的大きなずれがあり, イオ ンと中性クラスターの結合エネルギーの差異や,動的な解離過程 の影響などが考えられるが,理論計算のエネルギー値にもかなりの 不確かさが見込まれることから,解離パターンの差がどの程度の結 合エネルギーの差異と対応するかを知るために,実験結果から逆 にシリコンクラスターの結合エネルギーを推定してみた.前述の式 に代入して実験結果と近いフラグメントパターンが得られるように結 合エネルギー分布に最適化を施した.出発点としてFig.6に示した 理論計算の結果<sup>22</sup>を用い,ランダムに選んだサイズのクラスターの 結合エネルギーを微小変化させ、実験結果との差が小さくなる方向 を選択する.これを収束するまで繰り返す.この結果,Fig. 5 に見ら れるように実験結果とほぼ一致するフラグメントパターンを予測でき



Fig. 6 Optimized Binding Energy and Ionization Potential

る結合エネルギー分布(Fig. 6)が得られた.元の理論値と比較して 大まかな傾向は一致しており,結合エネルギーが解離パターンに 与える影響が大きいことが分かる.

5. 結論  $Si_2^+ ~ Si_1^+ O$ サイズのシリコンクラスターイオンと 355nm の レーザー光との干渉について以下の知見を得た. $Si_8^+$ 以下では中 性のシリコン原子を一つ失う解離過程が最も起こりやすい.これより 大きい場合は, $Si_9^+ Si_6^+$ , $Si_1^+ Si_6^+$ , $Si_1^+ Si_7^+$ , $Si_6^+$ の特徴的な解 離過程が存在する.また,理論値との比較から解離過程を支配する 条件として結合エネルギーの占める割合はかなり大きいと考えられ る.

本研究は文部省科学研究費(基盤研究 B)による補助を受けた. 参考文献

(1) 丸山・他3名,第34回伝熱シンポ (1997),687.

(2) M. V. Ramakrishna and A. Bahel, J. Chem. Phys, 104 (1996), 9833.

(3) K. Fuke · 他 3 名, J. Chem. Phys., 99 (1993), 7807.